

中信证券股份有限公司

关于有研半导体硅材料股份公司

使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为有研半导体硅材料股份公司（以下简称“有研硅”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对有研硅使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2047号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）18,714.3158万股，每股面值1.00元，每股发行价格为9.91元。本次公开发行募集资金总额为185,458.87万元，扣除总发行费用19,062.15万元（不含增值税），募集资金净额为166,396.72万元。上述募集资金已全部到位，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到账情况进行了审验，并于2022年11月7日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2201588号）。

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金总额	185,458.87万元
募集资金净额	166,396.72万元
超募资金金额	66,396.72万元
募集资金到账时间	2022年11月7日

二、超募资金使用安排

超募资金金额	66,396.72万元
前次已使用金额	46,926.57万元
本次超募资金使用用途	大尺寸半导体硅单晶基地建设项目
本次超募资金使用金额	19,470.15万元

注：前次已使用金额包括永久补流使用金额38,500.00万元、股份回购使用金额3,593万元及8英寸区熔硅单晶技术研发及产业化项目使用金额4,833万元。

三、本次使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的具体情况

(一) 项目概述

1、拟设立的子公司情况

公司名称：国晶半导体材料（包头）有限公司

注册资本：40,000.00 万元

注册地：内蒙古包头稀土高新技术产业开发区

出资方式：货币出资

持股比例：100%

经营范围：硅单晶、硅片等电子专用材料制造

（注：以上拟设立子公司信息以市场监督管理部门最终核定的信息为准）

2、新建项目基本情况

新建项目名称	大尺寸半导体硅单晶基地建设项目
实施主体	国晶半导体材料（包头）有限公司
实施地点	内蒙古包头稀土高新技术产业开发区
项目内容	建设约 5 万平方米的单晶厂房。厂房具备 140 个单晶炉位，可形成年产集成电路硅材料用单晶硅及集成电路刻蚀设备用单晶硅 1000 吨以上的生产能力。
项目总投资金额	40,000 万元（不包括设备投资；其中拟使用超募资金 19,470.15 万元、自有资金 20,529.85 万元）
达到预定可使用状态时间	2027 年 12 月

(二) 项目必要性分析

1、紧抓市场发展机遇，满足日益增长的市场需求

随着物联网、人工智能、汽车电子、大数据和区块链等新兴技术的快速发展以及移动终端的持续普及，市场对半导体产品的需求不断攀升，尤其是 8/12 英寸大尺寸硅片的需求增长尤为迅速。同时，随着刻蚀工艺在芯片制造中步骤和重要性的不断提升，作为刻蚀反应核心部件材料的技术迭代速度加快，市场需求持续扩大。为紧抓市场发展机遇，公司需加快合理布局产能，不断提高产业化能力。建设单晶制造基地，计划对 8 英寸硅片及刻蚀零部件实施扩产，以进一步提升公司产品的供货能力，巩固并提高产品的市场占有率和盈利能力。

2、优化产业布局、夯实产业基础，助力公司战略目标的实现

有研硅在当前产业规模上仍处于追赶阶段，公司需分阶段推进产能提升，依据市场

需求合理提升 8 英寸硅片及半导体零部件的产能，不断做大做强。目前公司单晶厂房无法满足扩产需求，本项目选址内蒙古包头，能够充分利用当地电力成本优势，提升产品竞争能力的同时，增强企业的盈利能力。通过实施本项目，将有助于推进公司半导体硅片规模化发展，解决限制公司发展的单晶难题，同时为“十五五”规划期间布局石英坩埚、多晶铸锭等新兴业务领域奠定基础，增强整体竞争力和行业影响力，推动公司发展战略的稳步落地。

（三）项目可行性分析

1、国家产业政策为行业发展筑牢基石保障

国家“十四五”规划明确将半导体材料列为攻关重点，经过五年发展，国内半导体硅材料和零部件产业取得了长足进步，为后续突破奠定了较好基础。“十五五”是我国全面实现半导体材料国产化的战略机遇期，国际环境、国内政策将持续支持半导体硅片和零部件产业发展，为该领域注入强劲动能。硅片和零部件作为半导体材料产业链的基础核心环节，市场规模较大，国产化替代空间较大，这为公司战略布局提供了明确方向。

2、核心技术体系为项目实施提供了硬核支撑

公司自成立以来，始终专注于半导体硅材料的研发、生产与销售，是国内最早从事半导体硅材料研发并率先实现产业化的单位。通过突破并优化多项关键技术，公司构建了一定的技术壁垒。截至目前，公司已获得多项硅片及半导体零部件生产工艺相关专利，形成具有自主知识产权的核心技术体系，为项目的顺利实施提供了有力支撑。

3、长期稳定的客户资源为项目推进奠定了坚实的市场基础

公司所处行业为集成电路先进制造领域，对产品质量、精细控制有较高要求，下游客户验证通常需要经历较长周期。公司长期秉承“技术领先，质量可靠，诚信进取，客户满意”的质量方针，已积累了一批长期稳定的核心客户群，与公司形成了紧密的战略合作关系。本项目将有力提升单晶材料的供应保障能力，符合市场和客户的预期，进一步巩固与深化现有客户的合作关系，为项目新增产能的顺利释放提供市场支撑。

（四）项目经济效益分析

项目的顺利实施将有助于公司扩大收入规模，提高公司产品的市场占有率和盈利能力，带来显著的经济效益。根据测算，在实现预期投入产出的前提下，项目税后内部收益率处于良好区间，动态投资回收期合理，项目具备经济可行性。

（五）项目主要风险分析

1、政策风险

尽管目前内蒙古包头在电力成本方面具有显著优势，但鉴于国家和各地新能源政策调整较为频繁，未来包头地区的电价政策及优惠力度存在不确定性。若相关政策发生不利变化，可能导致当地电力成本优势减弱，从而对项目的预期收益产生一定影响。

2、市场风险

本项目的市场风险主要表现为：一是半导体行业具有周期性特点，其景气度受宏观经济及下游消费电子、汽车电子、通讯等领域的波动影响显著。一旦市场进入下行周期，对新项目产能消化和营收稳定将构成挑战。二是伴随全球芯片制造产能向中国大陆转移，中国大陆市场将成为全球半导体硅片企业竞争的主战场，公司未来将面临国际先进企业和国内新进入者的双重竞争，面临未来市场竞争加剧的风险。三是硅材料产品价格存在波动或下降的风险，从而可能拉长投资回报周期。

3、团队建设风险

本项目选址内蒙古包头建设，部分关键技术骨干可能会因个人职业规划、家庭安置或子女教育等现实因素，赴异地工作的意愿不高，对新公司核心团队建设带来挑战。

4、项目进度未达预期的风险

公司使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目，是基于当前的经济形势、行业前景进行的慎重决策。但在项目实施过程中，受内蒙古包头当地冬季施工限制及各项行政审批等因素影响，可能存在项目进度未达预期的风险。

（六）保障募集资金安全的措施

公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定使用和管理募集资金，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。董事会授权公司管理层办理新设子公司开立募集资金存放专用账户相关事宜，专项存储本次公司投入的募集资金，新设子公司将与公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储四方监管协议。

四、履行的审议程序

2026年3月19日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目的议案》。本次超募资金使用事项尚需提交公司股东会审议。

五、保荐机构核查意见

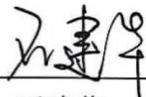
经核查，保荐机构认为：有研硅本次使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目，已经上市公司董事会审议批准，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对公司使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目的事项无异议。

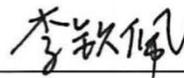
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于有研半导体硅材料股份公司使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



石建华



李钦佩

